

## Presseinformation

### **Viscom präsentierte IoT und Industrie 4.0 auf der APEX**

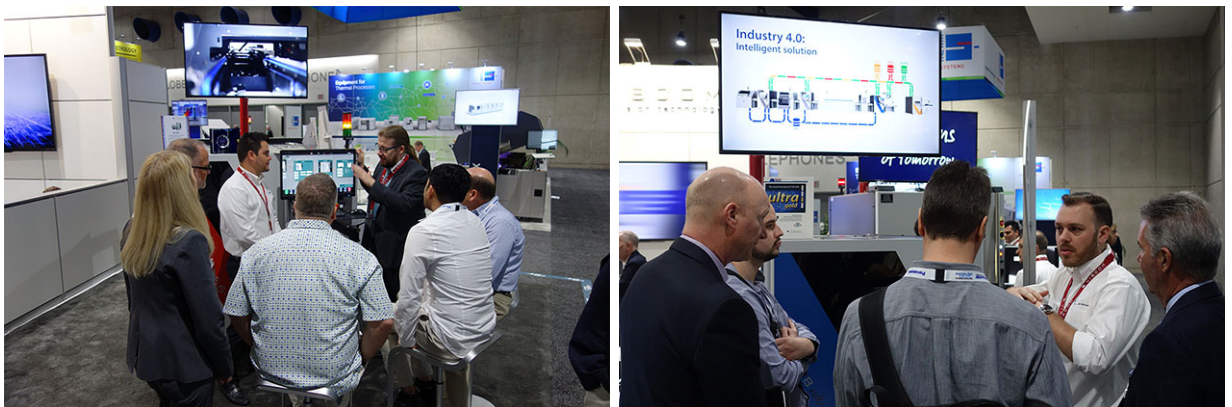
*Duluth, USA, März 2018* – **Viscom konnte die bisher beste IPC APEX EXPO verzeichnen: Mit einer Rekordzahl an Messebesuchern, die sich für die intelligent vernetzten Systeme „ready for i4.0“ begeisterten. Viscom hat vom 27. Februar bis 1. März 2018 in San Diego das vollständige Portfolio hochmoderner Inspektionssysteme vorgestellt, einschließlich 3D-SPI, 3D-AOI, 3D-MXI und 3D-AXI. Für seine zukunftsweisende Inline-Röntgentechnologie des Systems X7056-II gab es den New Product Introduction Award (NPI Award). Zudem war Viscom Partner der Initiative des IPC zu Connected Factory Exchange (CFX), die zum allerersten Mal live vorgestellt wurde.**

Die Präsentation des CFX-Projekts beinhaltete Live-Demonstrationen standardisierter IoT-Daten (Internet of Things) aus Viscom-Systemen über die Cloud auf den Handys der Besucher. Die Demo fand während der gesamten Messe statt: Die Messebesucher konnten auf ihren Privatgeräten in Echtzeit Analyseberichte verfolgen, beispielsweise die OEE (Overall Equipment Effectiveness; Gesamtanlageneffektivität), Einheitenzählungen sowie den Datenstrom in Echtzeit, über den aktuelle Ereignisse von den vor ihnen stehenden Maschinen gezeigt wurden. Ohne eine Software installieren zu müssen, ohne dass irgendetwas Proprietäres oder Middleware erforderlich waren, zeigte dies das wahre Wesen des IoT – mit CFX als hundertprozentig offenem Standard.

„Als AOI- und Röntgeninspektionsanbieter sind unsere Systeme die visuellen Sensoren jeder Industrie-4.0-Umgebung“, kommentierte Carsten Salewski, Präsident und CEO von Viscom Inc., der US-Tochter von Viscom. „Unsere Systeme liefern die Daten, die verwendet werden können, um Prozesse und Produktqualität zu verbessern. Ab Tag eins haben wir die Bestrebungen für die IPC-CFX-Standardisierung unterstützt. Es war sehr spannend zu sehen, wie das erste auf einem Standard basierende IoT-Netzwerk unserer Branche in San Diego ins Leben gerufen wurde.“

Bei der Umsetzung von Konzepten im Rahmen von Industrie 4.0 sind Inspektionssysteme für 3D-SPI, -AOI, -AXI und -MXI aus einer Hand ein klarer Vorteil. „So war Viscom natürlich früh mit verschiedenen Plattformen wie Quality Uplink und einer offenen i4.0-Schnittstelle beteiligt, über die sich Dritte mit unseren Systemen verbinden können“, betonte Salewski.

Viscom ermöglicht eine intelligente Verknüpfung der Ergebnisse aus den verschiedenen Prüftoren über das Software-Feature Quality Uplink. Der Bediener hat schnell Zugriff auf alle wichtigen Daten und Bilder. Die Inspektionssysteme können zudem voll automatisiert u. a. mit Bestückungsautomaten und Pastendruckern kommunizieren und auf ihre Parameter Einfluss nehmen (Closed Loop). Das Viscom Open Interface 4.0 macht es wiederum möglich, dass Kunden, die sich für ein 3D-AOI-System von Viscom entschieden haben, ihre Ergebnisse auch mit denen der ggf. vorhandenen Lotpasteninspektion eines Drittanbieters für eine vernetzte Beurteilung zusammenführen können. [www.viscom.de](http://www.viscom.de)



**Bildunterschriften:**

01\_3D-AXI-Vorführung mit der prämierten X7056-II

02\_Industrie-4.0-Lösungen und das 3D-AOI-System S3088 *ultra gold*

## **Über Viscom**

Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert Viscom seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen: <https://www.viscom.de/>